
/ Descriptions

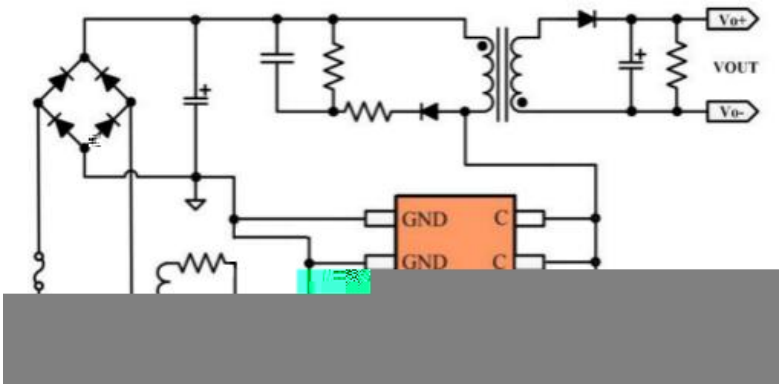
/ Features

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

/ Applications

-
-
-
-

/ Application Circuit



Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
	T_{LEB}			300		ns
	I_{PMAX}		300	330	360	mA
FB						
	V_{FB_REF}			1.2		V

V

/ Functional Description

BRAD6265DSC PWM

BRAD6265DSC

CC/CV

90V~264V TL431

/

BRAD6265DSC CC

CV FB

FB

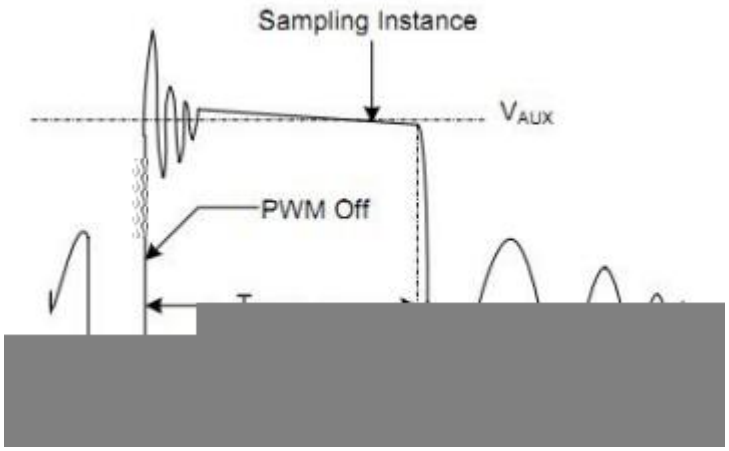
BRAD6265DSC CC/CV DCM

I_P

$$I_S \quad \frac{N_P}{N_S} \quad I_P \qquad 1$$

$$V_{AUX} \quad \frac{N_{AUX}}{N_S} \quad V_o \quad V \qquad 2$$

V



1

FB ! " # " $ GND % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 . / * 3 4 5 6 7 & 8 9 ' 7 : ; < . / = > ? @ A 8 B . / C D E . / *) F G H I J K L M *) N O I J C P Q R S T U V W ; X Y X Z 7 & [V W \ ] *) 0

^ # " _ ` a C FB b c d # " ' e f *) , - \ ] *) ' . / 0

BRAD6265DSC ( ) * + . / e g *) C * + ( ) h i @ ' *) F 1 j L M N O k l m n h C [o p \ ] *) V_O。

q # " r s \ ] *) t u v w x

$$V_O = \left(V_{FB} - \left(I_{FB} - I_{COMP}\right) R_{FBH}\right) \frac{N_S}{N_P} - V_D \quad (3)$$

{ # " r s \ ] *) t u v w x

$$V_{FB} = I_{FB} \cdot I_{COMP} \cdot R_{FBH} \cdot \frac{N_S}{N_{AUX}} - V_D$$

H

/ Functional Description

À È Ö@ × Ø ' R S V W ´ C BRAD6265DSC 1 j Ù l È § Ú ¨ © ¿ Û 0 FB ' . / *) Ü q j (" l x 1 Ý \ ] *) º) K # " e g @ FB ' *) Þ 2 Ý Ë Ì 1 j § Ú ¨ © * ( ) * + ß à Å ' *) C á â * F ; X Y X Z 7 & l ã N C F R S * l e N C ß ² ä i Ü å \ ] R S * º É ¸ Æ Ç ' \ ] *) º É Û æ i @ ç è ¨ © 0

BRAD6265DSC ' Â ° * Ë Ì 1 j , - b c C Í 2 8 â ¾ J Â ° * I_{PMAX} C é ê ë ì * Á ' ¾ J * C = í 1 j Í t î ï ð ñ * 3 ò ó ¿ ´ K ô 4 ; õ ö & ' * ÷ Â 0

BRAD6265DSC À È ø > ù ú ' ã Î ® ¯ C 1 2 È û ü > ý þ ÿ 0 á Ā > ý þ ÿ ā Ă ă) Ê p y UVLO z C VCC *) Ą ą C Ć > ý y OTP z C ć Ĉ ĉ * é ê y OCP z C \ ] Ċ 3 > ý C 1 2 î ï ð ñ * 3 ċ 0 Ë Ì Č * * č VCC ± ² ¶ ` ! Ď # " ď Č C » VCC Ð å , đ ă) Ê p ' Ē ° *) 7 C ; X E ē Ĕ X Z C Ò h ù ú ě Ė , đ ü õ T U 0

PCB

Í t BRAD6265DSC PCB 7 C è Ę ę Ě ² A M ě x

GND Ĝ ĝ PCB Ğ § x Ë Ì 1 2 CS * + C ù ú ß ç * ğ ē ¦ GND Ġ \ đ * ġ C Ģ PCB Ğ § è ġ Ã Ċ $ Ĥ C ĥ h Ħ đ \ đ * ġ R Þ

VCC * ġ xħ Ĩ ĩ ` 2.2uF Ī Ì X7R ī Ĭ * ġ Cĭ) ≥6.3V į ¡ ³ Đ + * İ * ġ 4.7uF/10V 0VCC ' * ġ è Ę ı IJ Ë Ì VCC $ GND Ĝ ĝ ,Ë Ì VCC Ĝ ĝ ij Ĵ ª ļ Ĝ § ĵ ğ ē Ķ l Ë Ì VCC Ĝ ĝ ķ ĸ Ú Ĺ Þ

FB . / Ĝ ĝ x Ħ @ FB ' ( ) * + Í Ļ IJ ¦ FB Ĝ ĝ C í Ľ ľ Ę Ł l · º) K ë ì # " ' Ė ľ C ^ # " _ ` 7 Ł è ł Ń . / * + | ń ¥ Ņ ĭ) Ę ņ Þ

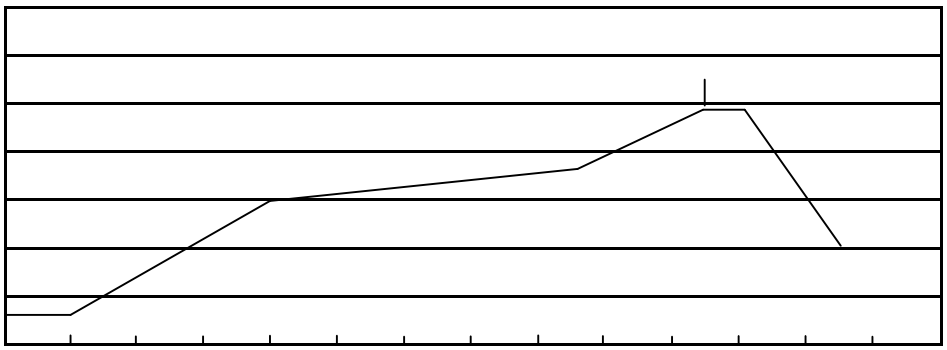
C Ĝ ĝ x Ň » ň ŉ C Ĝ ĝ ' Ŋ ŋ Ō ō ² ď į Ë Ì Ŏ ŏ Û Ő;

¿ ´ n 3 ő § x Œ œ ¿ ´ n 3 ' Ō ō C Ŕ º) K Ý C Ý ŕ § * ġ ' n 3 Ō ō C ² Ŗ º) K Ý W « ¬ Y Ý \ ] * ġ ' n 3 Ō ō C EMI ŗ Ř ř × Ø 0

Ś R S ś ° x ä ` Ŝ ŝ K Ş ş c Š VCC * ġ q ŝ k *) C è VCC ŝ k š p C í VCC>3.3V 7 C Ś R S + ° Ţ ţ Ť Ę ņ 0

0000

( ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



					Note:
1	150	180	60	90sec;	1.Preheating:150~180℃, Time:60~90sec.
2	245±5			5±0.5sec;	2.Peak Temp.:245±5℃, Duration:5±0.5sec.
3			2	10℃/sec.	3. Cooling Speed: 2~10℃/sec.

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

260±5℃	10±1 sec.	Temp.:260±5℃	Time:10±1 sec

/ Packaging SPEC.

/ REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOP-8	4,000	2	8,000	6	48,000	13 ×12	360×360×50	380×335×366

/ Notices